

EPMOLD MP50

軽量エポキシ系モデリングペースト

製品概要

EPMOLD MP50 はエポキシ系モデリングペーストです。遊星式ミキサーで混合し、粗形状の基体に手作業で厚さ 10-50 mm に施工して、室温で硬化できます。EPMOLD MP50 は可使時間が長く、発熱が少なく、大型モデル、型、軽量検査治具の製作に使用します。

主な特長

・ 混合比は質量比 1:1 ・ 長い可使時間と低発熱 ・ 手作業または遊星式ミキサーで混合可能 ・ 軽量で切削加工しやすい ・ 厚さ 50mm まで施工可能 ・ 切削後の表面がきめ細かい

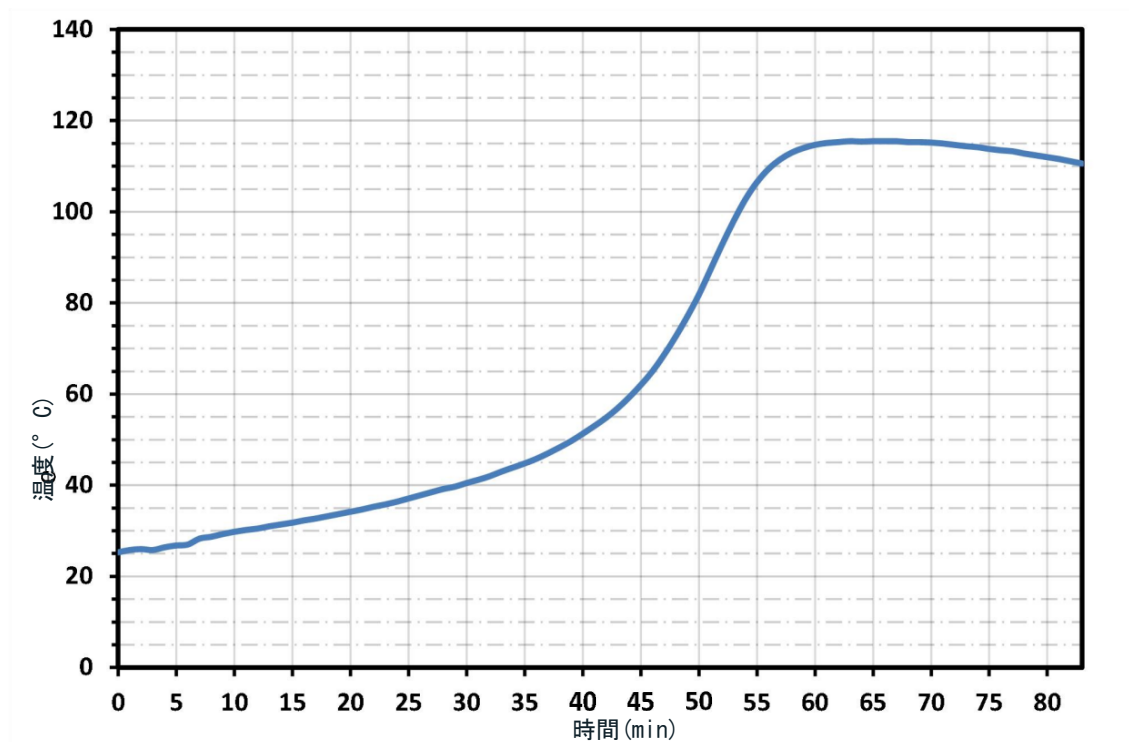
物理的特性

	試験規格	主剤	硬化剤
混合比(質量比)		100	100
外観	目視	ペースト状	ペースト状
色	目視	白色	ピンク
比重、25° C (g/cm3)	ISO1675:1985	0.50-0.55	0.45-0.50
硬化物の比重、25° C	ISO2781:1996	0.45-0.50g/cm3	
可使時間(500)、25° C		40-70min	
切削加工可能になるまでの時間、25° C		16-20 時間	
保存期間		12か月	

04/2026 EPMOLD MP50 エポキシ系モデリングペースト 1 / 3

発熱曲線

MP50 の発熱曲線、25 ° C(混合量 500g)



温度 (° C)

時間 (min)

機械的特性

	試験規格	EPMOLDMP50
硬度	ISO868:2003	ショアD52-60
曲げ強さ	ISO178:2001	10-20MPa
圧縮強さ	ISO604:2002	15-25MPa
Tg(25° C で 7 日硬化)	ISO11357:2002 (DSC)	>50° C
Tg(25° C 24h+40° C 16h)	ISO11357:2002 (DSC)	>60° C
熱膨張係数(CTE)	ISO11359:1999	約45*10-6K-1
最大施工厚さ		50mm

(1) 標準試験片で得られた平均値／硬化条件:40° C 16 時間

04/2026 EPMOLD MP50 エポキシ系モデリングペースト 2 / 3

加工・使用手順

両成分を指定の比率で、手作業または遊星式ミキサーで混合します。均一に混ざったら、粗形状の基体に押し付けて施工してください。支持体との接着を高めるため、先に手作業または工具で薄く下塗りすることを推奨します。室温で 16~20 時間硬化させてから加工してください。

荷姿

EPMOLDMP50 主剤	EPMOLDMP50 硬化剤
1 × 8.0kg	1 × 8.0kg

保管条件

両成分とも、15~25° C の乾燥した場所で元の容器を未開封のまま保管した場合、保存期間は 12 か月です。低温保管では材料が硬くなり混合しにくくなるため、40-60 ° C に加温し、十分に軟らかくしてから混合することを推奨します。この加温は最終製品の特性に影響しません。開封した容器は使用後すぐに密閉してください。

取扱い上の注意

取り扱い時は、十分な換気を確保し、手袋と保護眼鏡を着用するなど、通常の安全衛生上の注意事項を守ってください。詳細は製品安全データシートを参照してください。

品質保証について(必ずお読みください)

本書の情報は誠実に提供され、正確であると考えられています。ただし、製品の使用条件や方法は当社の管理の及ばない範囲にあるため、この情報をお客様による試験の代わりとすることはできません。意図した用途における安全性、有効性および適合性は、お客様自身で確認してください。

04/2026 EPMOLD MP50 エポキシ系モデリングペースト 3 / 3